중금속 오염이 n형 실리콘 태양전지의 전기적 특성에 미치는 영향에 대한 연구

김일환·박준성·박재근* 전자컴퓨터통신공학과, 한양대학교, 서울특별시, 04763

Influence of Metallic Contamination on Photovoltaic Characteristics of n-type Silicon Solar-cells

II-Hwan Kim · Jun-Seong Park · Jea-Gun Park*

Department of Electrics and Computer Engineering, Hanyang University, Seoul 04763, Korea

Received December 11, 2017; Revised December 22, 2017; Accepted January 16, 2018

ABSTRACT: The dependency of the photovoltaic performance of p-/n-type silicon solar-cells on the metallic contaminant type (Fe, Cu, and Ni) and concentration was investigated. The minority-carrier recombination lifetime was degraded with increasing metallic contaminant concentration, however, the degradation sensitivity of recombination lifetime was lower at n-type than p-type silicon wafer, which means n-type silicon wafer have an immunity to the effect of metallic contamination. This is because heavy metal ions with positive charge have a much larger capture cross section of electron than hole, so that reaction with electrons occurs much more easily. The power conversion efficiency of n-type solar-cells was degraded by 9.73% when metallic impurities were introduced in the silicon bulk, which is lower degradation compared to p-type solar-cells (15.61% of efficiency degradation). Therefore, n-type silicon solar-cells have a potential to achieve high efficiency of the solar-cell in the future with a merit of immunity against metal contamination.

Key words: Si solar-cell, PV characteristics, contamination, metal, n-type

subscript

 J_{SC} : short-circuit current V_{OC} : open-circuit voltage FF : fill factor PCE: power conversion efficiency

1. 서 론

태양광(photovoltaic, PV) 산업은 수십 년 동안 지속적으로 발전하며 성장을 지속하고 있다. 실리콘 태양전지 산업은 보다 더 높은셀 효율을 달성하기 위하여 표면 텍스쳐링(surface texturing)¹⁾, 플라즈마 도핑(plasma doping), 선택 에미터(selective emitter)²⁾, 후면 접촉 셀(back contact cell)^{3,4)} 등 다양한 연구와 개발이 지속 되었다. 태양광 산업의 성장을 주도한 것은 p-type 실리콘 기반 의 태양전지 셀이지만 최근에는n-type 실리콘 웨이퍼 기반의 태

*Corresponding author: parkjgl@hanyang.ac.kr

양전지 셀이 각광받고 있다⁵⁻⁷⁾. 일반적으로 인(phosphorus)으로 도핑되어 있는 n-type 실리콘 웨이퍼는 도펀트(dopant)로서 boron의 농도가 매우 낮기 때문에 붕소-산소 쌍(boron-oxygen pair)의 형성이 적다^{8,9)}. 붕소-산소 쌍은 소수 캐리어 재결합 수명 (minority carrier recombination lifetime)을 저하시키는 요인 중 하나이기 때문에⁹⁻¹²⁾ p-type 실리콘 태양전지 셀에 비해 n-type 태양전지는 침입 산소(interstitial oxygen, O_i)의 농도가 높더라 도 셀 효율에 비교적 영향이 적다. 비록 현재 태양광 산업의 핵심 기술이 p-type 실리콘 웨이퍼 기반의 태양전지에 최적화되어 있 지만 더 높은 셀 효율을 달성하기 위해 많은 기업 및 연구자들은 n-type 실리콘 웨이퍼 기반 태양전지의 잠재력을 높게 평가하고 있다.

또한 실리콘 태양전지는 가격경쟁력을 확보하기 위하여 제 조비용을 최대한 줄이는 것이 핵심이기 때문에, 잉곳 성장부터 웨이퍼링, 셀 제작, 모듈 공정이 반도체 산업과 비교하여 비교적 간단하다. 이는 결함(defect), 중금속을 포함한 불순물 오염에 취 약함을 의미한다. 반도체 소자에 비해 태양전지 셀은 디자인룰 이 상대적으로 크기 때문에 이러한 불순물에 대한 영향은 비교

© 2018 by Korea Photovoltaic Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License

⁽http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0)

which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

적 적게 받지만, 고효율 및 저비용 태양전지의 목표를 달성하기 위해서는 불순물이 셀 효율에 미치는 영향에 대해 파악하고 오 염을 방지해야 한다.

따라서 본 연구에서는 n-type 실리콘 웨이퍼에서 Fe, Cu, Ni 과 같은 중금속의 오염이 태양전지 셀의 전기적 특성에 어떠한 영향을 미치는지에 대하여 평가하였다. Fe, Cu, Ni 이온을 실리 콘 웨이퍼 벌크(bulk) 내로 확산(diffusion)시킨 후 태양전지 셀 을 제작하여 개방 전압(open-circuit voltage, Voc), 단락 전류 (short-circuit current, Jsc), 곡선인자(fill factor, FF), 전력변환효 율(power conversion efficiency, PCE) 등 태양전지 셀의 전기적 특성을 비교하였다. 또한 p-type 태양전지에 비해 n-type 태양전 지가 중금속 오염에 얼마나 덜 영향을 받는지를 평가하기 위하 여 동일한 농도로 중금속 오염 후 p-type 및 n-type 실리콘 웨이 퍼로 제조한 태양전지 셀의 특성을 비교하였다.

2. 실 험

본실험에는 200 μm 두께의 n-type 및 p-type 실리콘 태양전 지 웨이퍼를 사용하였으며, 중금속 강제오염을 위하여 Fe, Cu, Ni의 표준용액(from Kanto Kagaku)을 사용하였다. 0.1 ppm, 0.5 ppm, 1.0 ppm, 5.0 ppm, 10.0 ppm의 농도를 가진 중금속 용 액을 사용하여 2,000 rpm의 스핀 코팅(spin-coating)을 통해 실 리콘 웨이퍼 표면에 오염 용액을 일정한 두께로 코팅한 후, 실리 콘 벌크 내 확산을 위하여 900°C에서 15분 동안 질소 분위기에 서 열처리를 진행하였다. 그 후 790°C에서 POCl, 가스를 도포 한 뒤 870°C에서 3분 동안 phosphorus을 확산(diffusion)하였 다. 모든 웨이퍼의 전면에는 플라즈마 화학기상 증착법(plasma enhanced chemical vapor deposition, PECVD)을 통해 95 nm 두 께의 SiNx 막으로 반사 방지 코팅층(anti-reflection coating, ARC)을 형성하였다. Ag 및 Al 페이스트를 사용하여 스크린프 린터를 통해 상부 및 하부 금속 전극을 형성한 뒤 680°C에서 2초 간 급속 열처리(rapid thermal anneal, RTA)를 진행하여 태양전 지 셀을 제조하였다.

3. 결과 및 고찰

Fig. 1은 n-type 및 p-type 실리콘 웨이퍼의 중금속 오염농도 에 따른 소수 캐리어 재결합 수명을 보여주고 있다. 오염을 하지 않은 기준(reference) 샘플에 비해 Fe, Cu, Ni의 모든 중금속에 대하여 중금속 오염 농도가 증가함에 따라 소수 캐리어 재결합 수명이 감소하였다. 실리콘 벌크 내 중금속 이온은 실리콘 밴드 갭(band-gap) 내 트랩 에너지 레벨(trap energy level)을 형성하 여 재결합 중심(recombination center)으로 작용하기 때문에^{13,14)} 소수 캐리어 재결합 수명의 감소를 야기하며, 이러한 소수 캐리 어 재결합 수명의 감소는 셀 효율을 저하시키는 요인이다. Fig. 1(a)과 같이 n-type 실리콘 웨이퍼에 Fe, Cu. Niol 10 ppm의 농 도로 오염되었을 때 소수 캐리어 재결합 수명은 각각 88.97, 90.26, 83.78%로 감소하였다. 이에 비해 p-type 실리콘 웨이퍼 에 동일한 농도로 중금속이 오염되었을 때 Fig. 1(b)에서 보이듯 이 Fe, Cu, Niol 오염됨에 따라 소수 캐리어 재결합 수명은 각각 58.82, 65.98, 44.14%로 감소하였다. 즉, 동일한 농도로 중금속 이 오염되었을 때 n-type wafer에 비해 p-type wafer에서 소수 캐 리어 재결합 수명의 저하가 급격한 것을 확인하였다. 이는 양전 하를 갖는 중금속 이온들이 정공(hole)에 비해 전자(electron)의 capture cross section 값이 훨씬 크기 때문에 전자와의 반응이 훨 씬 쉽게 발생하기 때문이다¹⁵. 따라서 n-type 웨이퍼는 p-type 웨 이퍼에 비해 중금속 오염에 대해 높은 면역력(immunity)을 보유 하고 있다.

Fig. 2는 n-type 실리콘 웨이퍼로 제조한 태양전지의 중금속
오염 농도에 따른 셀 특성을 보여주고 있다. Fe, Cu, Ni의 모든 중
금속 종류에 대해 V_{0c} 는 Fig. 2(a)와 같이 중금속 오염 농도와는
무관하게 약 0.62 V로 일정한 값을 유지하고 있다. 반면에 Fig.
2(b)와 같이 모든 중금속 종류에 대해 중금속의 오염 농도가 증
가할수록 J_{sc} 는 감소하고 있다. 오염을 하지 않은 기준 샘플은
36.01 mA/cm²의 J_{sc} 값을 보이는 것에 비해, Fe, Cu, Ni을 10
ppm의 농도로 오염하였을 때 J_{sc} 는 각각 34.52, 34.84, 34.26
mA/cm²으로 최대 4.86%의 셀 특성 저하가 발생하였다. J_{sc} 는



Fig. 1. Dependency of minority-carrier recombination lifetime on the metallic contaminant type and concentration. (a) n-type and (b) p-type Si wafer

다음과 같은 함수로 이루어져 있다^{16,17)}.

$$J_{SC} = qgL = qg\sqrt{D\tau} \tag{1}$$

식에서 q, g, L, D, τ 는 각각 전하량(electron charge), 생성률 (generation rate), 확산거리(diffusion length), 환산계수(diffusion coefficient), 재결합수명(recombination lifetime)을 나타낸다. 즉 J_{sc}는 소수 캐리어 재결합 수명의 제곱근에 비례하기 때문에 소수 캐리어 재결합 수명이 감소함에 따라 J_{sc}는 감소하며, 소수 캐리어 재결합 수명의 저하 정도에 비해 제곱근의 비율로 감소 함을 알 수 있다. 또한 Fig. 3(c)에서 나타내듯이 FF도 중금속의 오염농도가 증가함에 따라 감소하고 있다. 오염을 하지 않은 기 준 샘플에서 76.37%의 FF 값을 보이는 것에 비해 Fe, Cu, Ni을 10 ppm의 농도로 오염하였을 시 각각 71.90, 73.13, 72.25%로 평균 5%의 FF 값의 저하를 야기하였다.



Fig. 2. Dependency of photovoltaic characteristics of n-type Si solar-cells on the metallic contaminant concentration and type. open-circuit voltage (VOC), (b) short-circuit current density (JSC), and (c) fill factor (FF)

Fig. 3과 Table 1은 n-type 및 p-type 실리콘 웨이퍼로 제조한 태양전지 셀의 전력변환효율을 포함한 전기적 특성을 나타내고 있다. 모든 중금속 종류에 대해 오염 농도가 증가할수록 J_{SC} 및 FF가 감소하였기 때문에 PCE도 동일한 추세로 감소하였다. 특 히 n-type의 경우 Fig. 3(a) 및 Table 1과 같이 Fe, Cu, Ni을 10 ppm의 중금속 농도로 오염되었을 때의 효율이 각각 15.28, 15.56, 15.25%로, 17.02%의 효율을 가진 기준 샘플에 비해 평균 9.73%의 셀 효율 저하를 야기하였다. 이에 비해 p-type 실리콘 웨이퍼에 동일한 중금속 농도로 오염되었을 때 기준 샘플에 비 해셀 효율의 저하가 평균 15.61%로 n-type에 비해 셀 효율의 저 하가 높은 것을 Fig. 3(b)과 Table 1을 통해 확인할 수 있다. 이를 통해 실리콘 벌크 내 중금속 오염은 태양전지 셀의 J_{SC}, FF의 감



Fig. 3 . Power conversion efficiency of metal contaminated solar cells as a function of contaminant concentration. (a) n-type and (b) p-type Si solar-cells

Table 1.	PV characteristics	of n-/p-type	silicon	solar-cells	with
	metallic contamina	nt concentra	ation of	10 ppm	

Contaminated metal		V _{oc} (V)	J _{SC} (mA/cm²)	FF (%)	PCE (%)			
Deference	n-type	0.62	36.01	76.37	17.02			
Reference	p-type	0.62	35.71	77.11	17.02			
Fo	n-type	0.62	34.52	71.90	15.28			
Гe	p-type	0.62	34.22	70.93	14.95			
<u></u>	n-type	0.61	34.84	73.13	15.56			
Cu	p-type	0.62	32.98	74.22	15.10			
Nij	n-type	0.62	34.26	72.25	15.25			
	p-type	0.61	32.45	66.22	13.04			

소로 인한 PCE의 저하를 유발함을 검증하였으며, 특히 p-type 에 비해 n-type 기반의 실리콘 태양전지가 중금속 오염에 덜 민 감하기 때문에 실리콘 태양전지의 고효율을 달성하기 위해 유 리함을 검증하였다.

4. 결 론

우리는 중금속 오염이 태양전지 셀의 전기적 특성에 미치는 영향에 대해 연구를 수행하였다. 실리콘 벌크 내로 중금속이 오 염됨에 따라 밴드갭 내에 트랩 에너지 레벨을 형성하여 소수 캐 리어 재결합 수명의 감소를 야기하였다. 이로 인해 Jsc, FF 및 셀 효율도 저하되었으며, 특히 p-type 실리콘 웨이퍼에 비해 n-type 실리콘 웨이퍼는 동일한 농도의 중금속이 오염되어도 소수 캐 리어 재결합 수명의 저하 정도가 낮아 셀 효율의 저하 정도가 상 대적으로 낮았다. n-type 기반 실리콘 태양전지는 붕소-산소 쌍 의 부재, 중금속 오염에 대한 면역력 등의 장점을 가지기 때문에 향후 태양전지 셀의 고효율을 달성하기 위해서는 n-type 태양전 지에 대한 많은 연구가 수행되어야 한다.

후 기

본 연구는 산업통상자원부의 재원으로 한국에너지기술평가 원(KETEP)의 신재생에너지핵심기술사업(No.20163030013390) 및 한국연구재단의 BK21 PLUS 사업을 통해 수행한 연구과제 입니다.

References

- P. Papet, O. Nichiporuk, A. Kaminski, Y. Rozier, J. Kraiem, J. F. Lelievre, A. Chaumartin, A. Fave, M. Lemiti, "Pyramidal texturing of silicon solar cell with TMAH chemical anisotropic etching", Sol. Energy Mater. Sol. Cells, Vol. 90, pp. 2319-2328, 2006.
- U. Jager, S. Mack, C. Wufka, A. Wolf, D. Biro, R. Preu, "Benefit of selective emitters for p-Type silicon solar cells with passivated surfaces", IEEE J. Photovolt., Vol. 3, No. 2, pp. 621-627, 2013.
- E. Van Kerschaver, G. Beaucarne, "Back-contact solar cells: a review", Prog. Photovolt: Res. Appl., Vol. 14, pp. 107-123, 2006.
- C. Gong, S. Singh, J. Robbelein, N. Posthuma, E. Van Kerschaver, J. Poortmans, R. Mertens, "High efficient n-type back-junction

back-contact silicon solar cells with screen-printed al-alloyed emitter and effective emitter passivation study", Prog. Photovolt: Res. Appl., Vol. 19, pp. 781-786, 2011.

- F. Feldmann, M. Bivour, C. Reichel, M. Hermle, S. W. Glunz, "Passivated rear contacts for high-efficiency n-type Sisolar cells providing high interface passivation quality and excellent transport characteristics", Sol. Energy Mater. Sol. Cells, Vol. 120, pp. 270-274, 2014.
- M. Taguchi, A. Yano, S. Tohoda, K. Matsuyama, Y. Nakamura, T. Nishiwaki, K. Fujita, E. Maruyama, "24.7% Record efficiency HIT solar cell on thin silicon wafer", IEEE J. Photovolt., Vol. 4, No. 1, pp. 96-99, 2014.
- K. Masuko, M. Shigematsu, T. Hashiguchi, D Fujishima, M. Kai, N. Yoshimura, T. Yamaguchi, Y. Ichihashi, T. Mishima, N. Matsubara, T. Yamanishi, T. Takahama, M. Taguchi, E. Maruyama, S. Okamoto, "Achievement of more than 25% conversion efficiency with crystalline silicon heterojunction solar cell", IEEE J. Photovolt., Vol. 4, No. 6, pp. 1433-1435, 2014.
- A. Rehman, S. H. Lee, "Advancements in n-Type base crystalline silicon solar cells and their emergence in the photovoltaic industry", Scientific World Journal 2013, 2013.
- D. Macdonald, L. J. Geerligs, "Recombination activity of interstitial iron and other transition metal point defects in p- and n-type crystalline silicon", Appl. Phys. Lett, Vol. 85, pp. 4061-4063, 2004.
- S. W. Glunz, S. Rein, J. Y. Lee, W. Warta, "Minority carrier lifetime degradation in boron-doped Czochralski silicon", J. Appl. Phys., Vol. 90, pp. 2397-2404, 2001.
- J. Schmidt, A. G. Aberle, R. Hezel, "Investigation of carrier lifetime instabilities in Cz-grown silicon", in Proceedings of the 1997 IEEE 26th Photovoltaic Specialists Conference, pp. 13– 18, 1997.
- J. Schmidt, K. Bothe, "Structure and transformation of the metastable boron- and oxygen-related defect center in crystalline silicon", Phys. Rev. B, Vol. 69, pp. 024107, 2004.
- K. Graff, Metal impurities in silicon-device fabrication, Springer Science & Business Media, 2013.
- A. A. Istratov, E. R. Weber, "Electrical properties and recombination activity of copper, nickel and cobalt in silicon", Appl. Phys. A, Vol. 66, pp. 123–136, 1998.
- A. A. Istratov, H. Hieslmair, E. R. Weber, "Iron and its complexes in silicon", Appl. Phys. A, Vol. 69, pp.13–44, 1999.
- B. G. Streetman, Solid State Electronic Devices, Pearson Prentice Hall, 2006.
- S. M. Sze, Physics of Semiconductor Devices, John Wiley & Sons, Inc., 2007.